

Press Release

2016/08/01

ヘンケル、熱伝導性ギャップ充填材料の新製品 Gap Pad[®] HC 5.0 を開発

～電力密度が高いアプリケーションの熱対策向けに熱伝導性能を向上～

ドイツの化学・消費財メーカー ヘンケルのエレクトロニクス事業部は、シート状の熱伝導性ギャップ充填材料 Gap Pad(ギャップパッド)*の新製品:Gap Pad HC 5.0 を開発しました。Gap Pad HC 5.0 は、小型化し、電力密度が高くなった部品や基板への熱対策に要求される熱伝導性能に対応した製品です。

■ 開発経緯

電子部品は小型化と同時に、電力密度が高くなっており、熱対策への要求は以前より高まっています。インターネットやコンピュータを利用するインフラで使用される部品や基板において、優れた熱伝導性能が必要とされており、そのために、Gap Pad HC 5.0 を開発しました。

Gap Pad HC 5.0 を用いることにより、今よりもジャンクション(接合)温度を下げ、デバイスの性能の向上が可能になります。本製品は、次世代の電力密度の高いアプリケーション向け熱伝導性ギャップ充填材料です。

■ 特長

Gap Pad HC 5.0 は、熱伝導率 5.0 W/m-K のギャップ充填材料です。その高い熱伝導率に加えて、形状追従性が高く、圧縮応力が低いことが特長です。低荷重でも優れた熱特性を発揮するため、組立時に部品や基板に加わるストレスを最低限に抑える必要があるアプリケーションに適しています。また、表面粗さあるいは高低差の大きい表面に対しても形状追従性を維持するため、素早い形状回復および優れた濡れ性を実現します。



Gap Pad HC 5.0 は、欧米で今年 6 月に発売を開始、日本でも年内には販売開始予定です。

*熱伝導性ギャップ充填材料 Gap Pad(ギャップパッド)

高さが異なる様々な部品が実装された基板を筐体フレームなどと直接熱的に接合することが可能なシート状の熱伝導性ギャップ充填材料です。シート状に成形されているが、ペーストやジェルのような充填性をあわせ持つ画期的な熱対策材料です。

ヘンケルについて

ヘンケルはブランドとテクノロジーのグローバルリーダーとして、ランドリー&ホームケア、ビューティーケア、アドヒーズブテクノロジーズ(接着技術)の3つの分野で事業展開をしています。ヘンケルは1876年の創立以来、コンシューマービジネスおよび産業分野において、Persil (パーシル)、Schwarzkopf(シュワルツコフ)、Loctite(ロックタイト)などに代表される有名なブランドの数々と共に、グローバルにおけるマーケットリーダーとしての地位を維持しています。ヘンケルの従業員数は約50,000人であり、2015年の売上高は181億ユーロ、調整後の営業利益は29億ユーロを計上しました。ヘンケルの優先株はドイツ株式指数DAXのリストに入っております。

ヘンケルジャパン接着技術事業部門ホームページ: www.henkel-adhesives.jp

ヘンケルジャパンフェイスブックページ: <http://www.facebook.com/HenkelJapan>

— 本件に関するお問合せ先 —
ヘンケルジャパン株式会社 接着技術事業部門
マーケティング部 担当: 清 晴世
TEL: 045-758-1784 e-mail: haruyo.sei@henkel.com